

300mm 半自动真空贴合机

RAD-2512m/12



概述

半自动真空贴片机，可对晶圆进行切割胶带真空贴覆。

通过使用我们独特的真空控制方法，可以在不接触晶圆表面的情况下进行晶圆贴膜。

通过使用我们独特的压差控制机制，可实现与阶梯表面的完美贴合。

选配功能 · 加热台

适用的胶带 · 切割胶带: Adwill D系列, G系列

规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
	功耗	: 15kW
气源	供气压力	: 0.6-0.8MPa
	耗气量	: <100L/分钟 (ANR)
真空供给		
(真空腔体)	极限压力	: 1.0Pa
	排气速度	: >250L/分钟

适用的晶圆尺寸

150mm, 200mm, 300mm (翘曲: >2mm)

尺寸

机台宽度(W) : 1,100mm
设备纵深(D): 660mm(不包括突出部分)
设备高度(H): 1,098mm
(当上室完全打开时)

重量

400kg

UPH

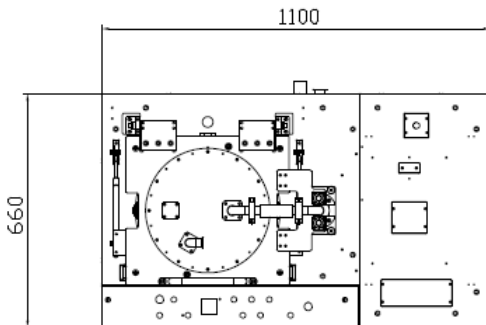
60秒/片 (不包括凝结时间)

· 上述处理能力依据的条件如下。

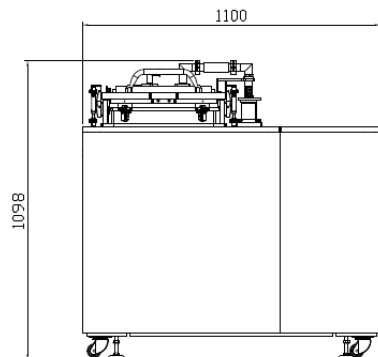
晶圆 : 200mm 镜面晶圆

设备外形图

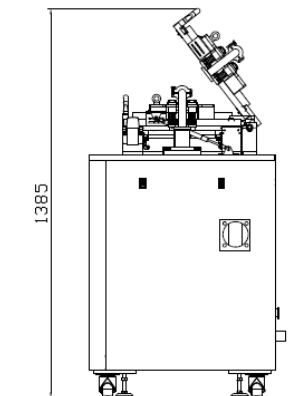
单位:mm



平面图



正面图



右侧面图



LINTEC Corporation Linking your dreams

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

<https://www.adwill-global.com/cn>